

2021 年度第 1 四半期 決算説明会 Q&A

登壇者：代表取締役社長 中島 規巨

取締役常務執行役員 コンデンサ事業部 事業部長 石谷 昌弘

取締役常務執行役員 経理・財務・企画グループ統括部長 南出 雅範

【業績概要・予想】

Q. 部品の取り込み需要の前提は、PC 以外全体的にちょっと下げられているにも関わらず、売上の前提はクォーターおしなべて、従来予想よりも上がっている。この差は何が起きているのか教えてください。多分、その部品需要というのは、お客様の在庫取り込みも入っていると考えています。

A. 主に車載向けが、半導体不足による部品全体の調達リスクがあり、おそらく先行的な部品取り込みがかなり起こっています。当初、下期にかけてそれが解消されていくと考えていましたが、過大な部分は解消されるものの、在庫の水準自体の考え方が、車載メーカー、あるいは関連の代理店で大きく変わったと捉えています。

Q. 従前、中華圏スマホの影響が 4～6 月に出ていると話されていた。これはちょっと遅れましたけれども、そのとおりに出てきたと思います。今年の 10～12 月ぐらいから、自動車メーカーが部品を取り込み過ぎて、コンデンサでその反動があると言っていたと思います。しかし、今回の予想を見ていると、コンデンサの上期、下期、または車の上期、下期を見てもそんな落ちではないので、見方がだいぶ変わってきている。来年度に向けて順調な売上になるというソフトランディングシナリオになってきたかどうかを確認させてください。

A. 中華圏スマホに関しては想定より少し遅れたんですけど、4 月以降、Q2、Q3 にかけて、ダウントレンドに入っていると認識しています。新機種の立ち上げが年始めぐらいに始まると思うので、部品取り込みベースで年末ぐらいから復調すると考えています。MLCC の調整については、以前、もう少し早い段階で調整局面を想定していたが今の段階でもそれほど需要が落ちていない。セットメーカー、あるいは車メーカーの生産台数から考えると、少し適正な在庫水準が上がっている。まだその反動が現れていないが、少し下期に反動が出てくると推定しております。

Q. セット台数はチャネル在庫除きの実際に使われる部品だと思う。チャネル在庫や、お客様が蓄えている在庫が、過去より大きい水準になってきたと考える。また、半導体のボトルネックが解消されると、生産そのものが車とか上がってくる。上期、下期だとちょっと落ちるとしても、調整が下期ちょっと遅れているというのは、遅れて来年度に調整が起きるのか。それともこれがニューノーマルで、下期の在庫水準をフラットな状態として、来年度は実需見合いで伸びていくと考えるべきなのでしょうか。

A. サプライチェーン上の半導体の取り込み次第です。車業界が、これまで進めてきたような JIT よりも、今は適正在庫水準が高くなっている。それは新しいノーマルになっていると思っています。ただ、われわれの肌感覚でいうと、まだまだ半導体が復調するには少し時間を要する。22 年に入るという読みをしています。理由は、各種半導体メーカーはそれなりの投資をしているが、最先端領域をメインに投資されていて、車とか産業機器で使われるような、例えば 40 ナノのマチュアなプロセスについては、あまり増産投資がされていない。正常化するのに少し時間を要すると考えています。

Q. お客様の生産の盛り上がりがちちょっとスローであれば、一旦需要は穏やかになるけれど、お客様の生産が戻れば、それに伴ってコンデンサの需要が戻ってくるということですね。

A. はい、おっしゃるとおりです。

Q. 2Qに売上が増加する計画である反面、利益が減少する理由について教えてください。

A. ご指摘のように売上高が増加しますが、営業利益は、第1四半期が1,051億円から第2四半期は989億円になります。この要因は、主に品種構成の差が大きく影響しております。第2四半期は、北米のスマホメーカーへの売上が季節的に大きく立ってきますので、モジュール製品の生産高の比率が上昇してきます。その影響が一番大きな要因です。売上高は、第1四半期から第2四半期に大きく増加しているんですが、製造高に関しましては、第1四半期と第2四半期がほぼ同じぐらいです。ですので、先ほどの品種構成の影響で、若干第1四半期に対して減益となります。

Q. 1Qから2Qへの変化なんですけれど、コンデンサなどのコンポーネントは、売上は増えるんでしょうか、それとも減るんでしょうか。

A. 第1四半期から第2四半期ということでは、売上が増えるのはコンデンサ、その他コンポーネントの主にインダクタ、電池、モジュールも増加します。圧電製品以外は、第2四半期は第1四半期に対して増加するような予想となっております。

Q. 現状の需要、売上について教えてください。まず現状で、お客様の要求量の中で、どれぐらい安全在庫の積み増しが入っているのか。例えば1割多いとか2割多いとか、各用途分野でどれぐらい多い取り込みになっているのか。今の御社のフィーリングを教えてください。

A. 正直申し上げまして、その細かい分解というのはできておりません。ただ言えるのは、先ほど、車載向けで安全在庫の積み増しのお客様のほうであるだろうと申し上げていましたけれども、コンピュータ関連機器でもそのような動きがあります。全体にあるんですが、コンピュータ関連機器でもかなり強い受注が入っているというのは続いております。今後については、われわれが読んでいる半導体のサプライチェーン上の問題というのが、もう少し早く解決するだろうと読まれているお客様が多いと認識しており、もしそこが解消されれば、非常に実需に近いところになってくると思っています。

Q. あと今回、通期の売上高を700億円上方修正されておられますけれども、その中で実需としての修正分、安全在庫積み増しに伴う修正分を分解するとどんなイメージになるのか。さっきの需要前提と売上前提が必ずしも一致していないと思うので、ヒントをいただけるとうれしいです。

A. 実需での修正分と在庫積み増しによる修正分というのは、そこまでの分解はできていません。安全在庫のお客様の積み増しの影響に加えて、部品が不足するという状況の中で、比較的供給能力の高い村田のコンポーネンツ部品、主にはコンデンサですが、頼られて発注が増えているのではないかと推測しています。

Q. それは発注ベースで見れば、シェアアップみたいな形になっているということなんですか。能力のあるところに注文が来ているということですか。

A. そのとおりです。

Q. 中華圏スマホのマイナスの影響は多分、本当の生産はQ1に落ちているはずで、ここから落ちるというよりはQ1にもう既に落ちたと思う。部品の取り込みはここから調整して、2Q、3Qと落ちていくようなイメージになると思う。中華圏スマホ向けの出荷、特に圧電のボトムは2Qなのか、それとも3Qなのか。Q2に下がってそれが横這いみたいなイメージでいいのか。4Qから復活するようなシーズンリティを見ればいいのでしょうか。

A. 少し感覚的なところになりますが、ボトムは2Qかなと。3Qの後半から取り込みが始まると考えています。

【コンデンサ】

Q. 設備投資についてコンデンサの能力の増強を追加的に上げられているのかどうかを確認させてください。

A. コンデンサの生産能力は従前からご説明していますように、年間 10%程度のペースで拡大を進めているところです。生産個数の話ではなくて生産負荷ベースであり、今後伸びる自動車向けや超小型というところに厚く配分するように能力の増強を図っていきたいと考えています。また、コロナや半導体不足などいろんな影響で需要が高止まりしており、少し来年の投資を前倒して能力の増強を少し加速させていきたいと考えています。

Q. 注残がコンデンサにおいて、だいぶ積み上がっていますけれども、これがどういった形で今後解消されていくと考えるべきでしょうか。

A. コンデンサについては Q1 までの受注、売上に今ご説明したような安全在庫の積み増しであるとか、先行的な手配の部分がありました。Q2 については Q1 よりも売上が増加すると見込んでいます。Q3 以降に関しましては、そういうものが更に増えていくということはありません。実需見合いで堅調に推移するのではないかと想定をしています。

Q. Q2 の生産高について質問をさせてください。4,500 億円、Q1 比でフラットということなんですけれども、ここでコンデンサだけを取り出すと、生産高はもうこれ以上上げられないような状況でいらっしゃるのか。それとも、キャパが段階的についてくるんで、もう少し引き上げる余地があるのか。Q1 の値下がりというのが、前四半期比で見ると 30 億円しかなくて、前年同期比で見ると 120 億円、非常に低い値下がりになっています。一方で、通期予想を見ると、値下がりとは従来よりも大きくして、730 億円だったのを 750 億円にされている。それから考えると、Q2 に値段が下がるという前提が入っているような気がしていて、そうすると生産高が上がらないという建付けになってしまう。仮に値段が下がらなければ、その分生産高は上がっていくという考え方でいいのかを整理させてください。

A. MLCC の生産ですけれども、実際には設備は段階的に入ってきておりますし、それを戦力化していきますので、時間を追うごとに徐々に上がっていくと想定をしています。ただ、コロナの中で操業度はフルですけれども、コロナ対応のための安全運転だとか、ちょっとでも体調が悪ければ出社しないとか、いろんな細かなことはございますので、本当のフル操業というところと比べると、微妙にそこに届いていないという中での操業は続くだろうと思います。価格につきましては正直、ここまではあまり動いておりませんが、下期につきましてはやっぱり一定の値下げ、巡航速度的な定期値下げ等々はございますので、そういうものと相殺をすると金額ベースで大きく期末に向けて伸びるということにはならない。あるいは少し伸びた部分については、在庫としてしっかり積み上げて来期に向けて対応していきたいと考えております。

Q. スペシフィックに Q2 の生産高というのは、Q1 比で上がると思っていいですか。つまり、値下げを結構きつく入れていらっしゃるって、表面的に上がらないという前提をつくっていらっしゃるのか。

A. Q2 については、ほぼフラットプラスアルファぐらいの値下げ前提としています。

Q. MLCC に対して、BCP 在庫のところの考え方が変わってきているということで、実需を超えた受注になっているという話がありました。今後、ちょっと在庫を厚めに持とうとするための発注を出し終えたところで下がっていくという状況があると思います。適正水準に戻ったところで、コンデンサのところは相変わらず BB レシオ 1 超えを維持できるかどうか、今の感触を教えてください。在庫の変動が長くなったとき、要するに今は在庫を積み増すために余分なオーダーが入っていると思いますが、それがいずれ巡航速度になる。実需に連動した受注が入ってくるということで、おそらく BB レシオは底を打つかなというふうに思う。その底を打った段階で、売上よりも受注の水準が超えているのかどうか見通しを教えてください。

A. 在庫を積み上げていろんなリスクに備えているというような状態になってきているというのはここまでの動きです。その水準を積み上げるというプロセスは、この Q1 ぐらいでおおよそ終わったという理解をしています。それを下げる動きが短期的に起きるかというそれはないだろうということで、今年度の業績予想をしています。おそらく来年以降につきましても、コンシューマ向けの一部は状況に応じて適正在庫を、0.3 カ月、0.5 カ月落としていくことが出てくると思います。けれども、自動車向けについては、当面こういう水準の中で動いていくと思いますので、在庫を理由とした調整がそう大きく起きるというふうには見ていません。そういう意味では、この下期の売上が、来年以降を考える上でのベースになってくると考えています。

Q. 下期になると、ある程度の今の在庫の水準がすっかり決まってそこで落ち着いてくるという段階に入る。例えば 3Q あたりがノーマルな状況、在庫が変動せずに実需ベースの発注になるといった段階で、例えば BB レシオが 1 を超えていくとか、そういう状況が今後も続くというふうな見方でよろしいでしょうか。

A. はい、おおよそそのような見方となります。3Q はまた特定のお客様のインパクトもありますので、3Q と 4Q の平均ぐらいを見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。

Q. ダウンサイジングについてなんですけれども、今こういった需給逼迫する中で、車メーカーもあまり設計を変えたくないという話が元々ありましたが、こういったダウンサイジングのトレンドというのは進んでいるのかどうかというのについても確認させてください。

A. 小型化の方は、今急激に小型化が進んでいる、スピードが上がっているということはないですけれども、MLCC のタイトな状態というのがいろんな理由でこのところ繰り返されていますので、やはりより入手性の高い領域、あるいはサプライヤー側の増産意欲の旺盛な領域への設計の変更であるとか、新しいものからの採用は着実に進んでいると、理解をしています。

Q. MLCC について、競合企業が内部電極をニッケルから銅に切り替える試みについて説明をされていました。御社はだいぶ前から、銅を内部電極に使った製品を量産されています。今後ニッケルから銅に内部電極が切り替わる可能性があるのかどうかについて教えてください。

A. MLCC の内部電極ですけれども、銅を電極に使う製品というのは従前からございます。5G とかいろんな周波数が高いところで使われるため High Q のコンデンサの需要が伸びていくと、そこで銅の電極品が使われるということで関心を持たれているんだろうと思います。需要が伸びていくという事実はあると思いますけれども、従前ニッケルでやっていた領域を銅に変える動きが出るということではないと理解をしています。

Q. 内部電極の切替えを採用する、しないという境目になるのは、ミリ波の領域なんでしょうか。こういった周波数のところで、こういったものが想定されているのか教えてください。

A. おっしゃるように、ミリ波が一つトリガーになります。高周波領域での ESR をどこまで抑えるのかというところで、銅電極が村田では古くから使われています。すぐく特殊用途で、高周波領域かつアンテナのマッチングだとか、あるいは計測器とかの高精度が必要なもので一部使われているものになります。その用途は需要としては徐々に高まってくると思いますし、ミリ波というのは一つのトリガーだと思っています。

【モジュール】

Q. モジュールの売上高見通しを下方修正した背景について教えてください。RF モジュールは、来年度シェアを挽回するというものでしたけれども、大手スマホメーカーとの取引拡大の見通し、台湾のチップセットメーカーなどのリファレンスの状況について教えてください。

A. まず、モジュールの売上の下方修正について大きく二つ要因があります。一つ目は以前の計画から比較して、半導体が十分に入手できていない、入手できる見込みにないという状況にあり、車載向け、あるいは産電向けの Wi-Fi モジュールを中心に、十分な部資材を確保できていないということが大きな理由になります。もう一つは、今年はハンドセットでいうと半分ぐらいに、あるいは半分強にミリ波の 5G が入ってくると想定していましたが、今のインフラの整備状況を鑑みると、そこまでアタチレートが上がらない状況にあります。そこで、今回、われわれの読みについても下方に修正をしました。この二つの理由で、モジュールの下方修正につながっています。米国のお客様の来々モデルに対してのアプローチは、これまでの反省も十分踏まえて早めのアプローチを開始することができています。新技術も取り入れて積極的な提案をしている状態ですが確定、あるいは状況をご説明するには時間を要します。台湾のチップセットメーカーの新しいリファレンスデザインについては、拡販はうまく進んでいるんですけど、少し遅れ気味になっています。先ほど申し上げたように、Q2、Q3 というのは中国のマーケットは少しダウントレンドで、Q4 にはそういった新しいプラットフォームが広く使われてくるだろうという方向感が出ていますので、挽回は十分可能だと考えています。

Q. モジュールの XBAR の話を教えて下さい。来年、モジュールに乗せたいという話をされていた。来年モデルに入れようと思うと、もう既にお客様に出していないといけないうタイミングで、評価が始まっているタイミングになっていると思う。今、どれぐらい出来上がっているのかと、お客様の評価は。それとプラットフォームが多分、来年そんなに変わらないという話が、今おそろく出ていると思います。今年のプラットフォームを引っ張るんじゃないかみたいな話になっていると思います。お客様の都合で採用が少し延びるような可能性をどう見てらっしゃるのか、その点について教えてください。

A. XBAR の技術開発については順風満帆とは言わないですけど、結構技術的な課題も抱えながら進めていまして、サンプル活動もそれなりに行っています。ただ、来年モデルで採用されるかどうかというところでは、私どもも従来持っている SAW フィルタ、あるいは I.H.P、そういった技術も合わせて提案をさせていただいていますので、どの技術が採用されるかというのは、まだちょっとわからない状況です。昨年の二の舞にならないように、きっちりサポートはできているかなと考えています。

Q. モジュールのところで、半導体の調達等が少し今ショートしているという話がありました。解消の見通しをどういうふうに立てられているのか。あと、RF 系の PA 等は大丈夫なのか。この先の見通しも含めて教えてください。

A. IC と一言で言っても、バリエーションはあるんですけど、まず PA とか化合物半導体は特に大きな問題になっていません。あと、CMOS の PA についても、最先端技術を使っているケースが多いです。デザインルールの最先端のものを使っているものについては、どこの CMOS メーカーも結構積極的に投資をされているもので、そこでのサプライチェーン上の問題というのは発生しないと思っています。一方、車で使っていただいている、あるいは産電で使っていただいているような無線の Wi-Fi のモジュールだとか、Bluetooth のモジュール、こういったものは先ほど申し上げた 40 ナノとかといった少し世代の古いプロセスを使っている。根本的な問題は古いプロセスに対してどこも投資していない点にあります。これに対して、二つしか施策がなく、一つは最先端プロセスに近いプロセスのものに置き換えていくという作業、この作業は鋭意行っています。もう一つは、どうしてもリードタイムがもう半年レベルではなくて、もっともっと長くなっていますので、長期のリードタイムに対して早めにオーダーをかけていくという、この二つの施策しかないと思っています。双方で今取り組んでいるという状況です。

当Q & Aに記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。

(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当Q & Aに記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。